

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

482

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

08.06.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	150		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
B-RS-FR4-ML-0.20mm-070+070-TG150-HF	50200889	70	L2	4
		200		
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	150		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	7

Dicke nach Verpressen

B00:

690 µm

Tol+:

80 µm

Tol-:

80 µm

Dmax:

770 µm

Dmin:

610 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

800 µm

Tol+:

80 µm

Tol-:

80 µm

Dmax:

880 µm

Dmin:

720 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

676 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik